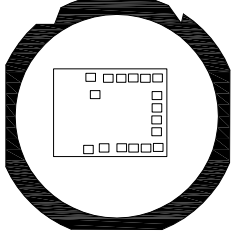
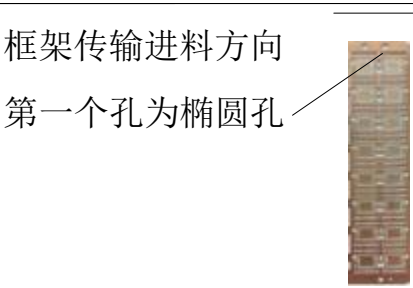
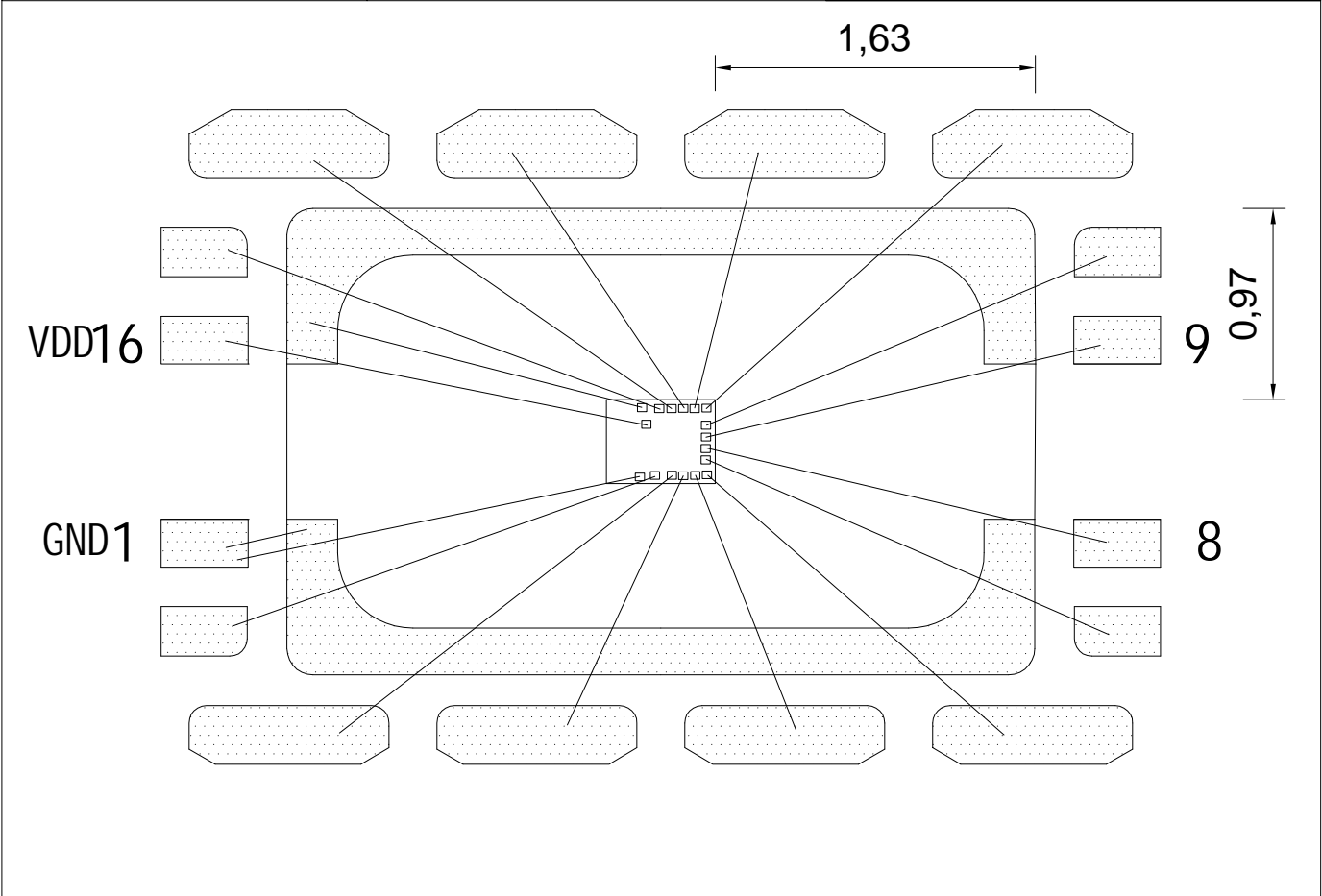



江苏芯丰集成电路封装压焊图			图号: 314BD002	版本	A.0
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 				
			备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）		



顶针		点胶方式	
单顶针	多顶针	点胶	画胶
	/		/
产品型号 (Product Type) :		HS9000P-P16	线材直径 (Wire Diameter) :
芯片名称 (Die Name) :		HS5122	银合金线0.8mil (Chip thinning thickness)
芯片尺寸: (Die Size) :		0.5548×0.4332mm	
封装形式 (Package Type):		SOP16L(9.9×3.9×1.4e=1.27)	最小压焊间距 (Min Pitch) :
引线框 (Lead Frame) :		SOP16L(12R)(94×150)	先焊线 (Wire Bond Start):
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):		雾锡	焊线总数 (Quantity of Wire) :
晶圆尺寸 (Wafer Size) :		/	最长线长(Length of longest Wire):
吸嘴 (suction nozzle)		RR10×10	切割道 (Cutting Way)
拟制 Prepared by		钱培丽 2022.6.8	审核 Checked by
			批准 Approved by